商工建設常任委員会資料

令和6年10月29日 商工観光労働部 目 次

1. その他報告事項

(ページ番号)

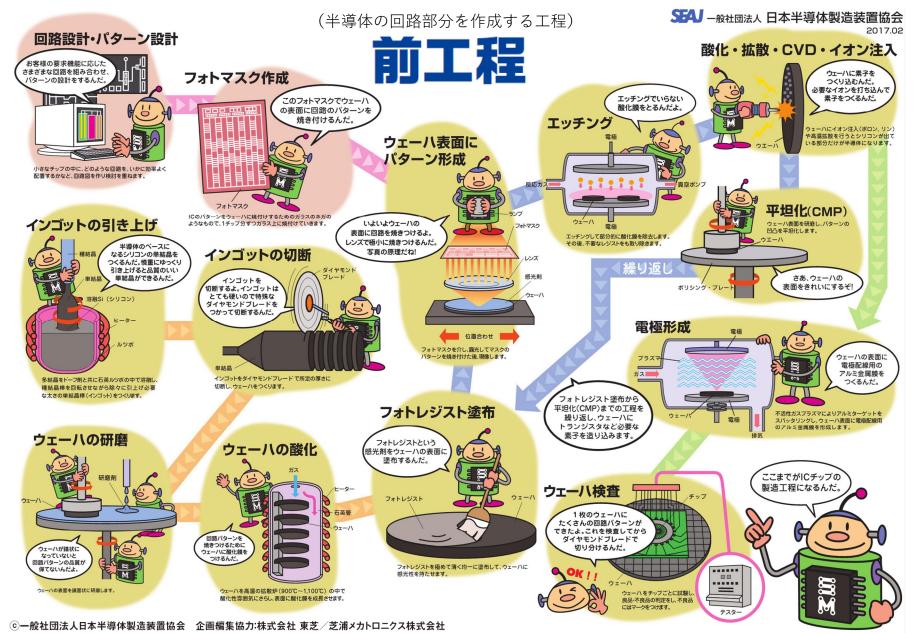
○宮崎県内の半導体企業及び半導体関連企業の状況について・・・・・・ 3-8

1 その他報告事項

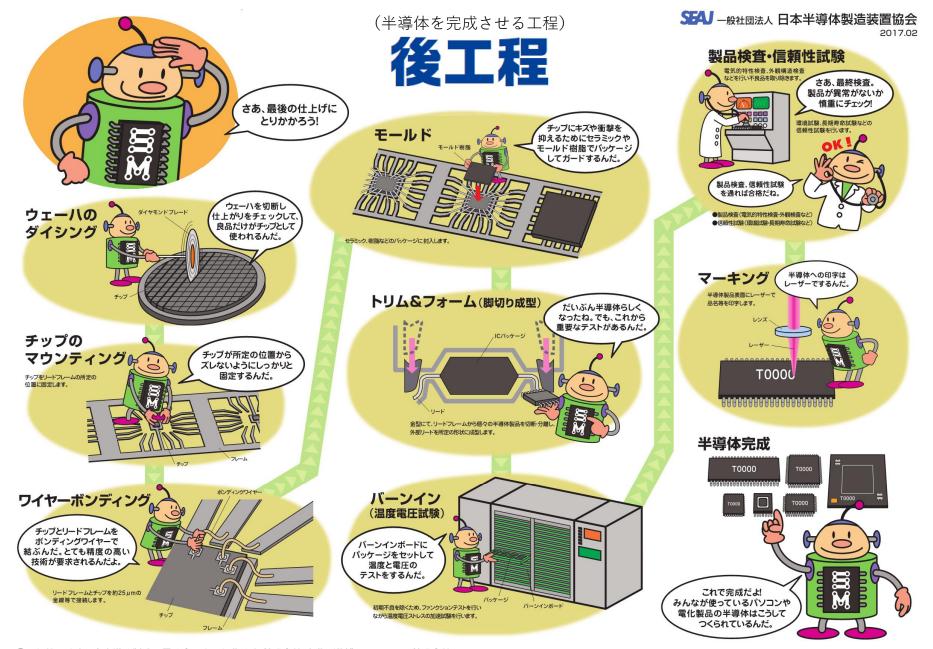
宮崎県内の半導体企業及び半導体関連企業の状況について

企業振興課

1 半導体の製造工程について



1 その他報告事項(宮崎県内の半導体企業及び半導体関連企業の状況について)



1 その他報告事項 (宮崎県内の半導体企業及び半導体関連企業の状況について)

2 県内の半導体企業・半導体関連企業について【半導体分野(前工程)】

「九州半導体関連企業サプライチェーンマップ(2022.3)」より

回路設計・パターン設計

(3事業所)

- ・何アナロジスト
- ・旭化成マイクロテクノロジ㈱
- ・㈱吉川工業アールエフセミコン

パターン形成・製膜

(2事業所)

- ・ラピスセミコンダクタ(株)
- ・旭化成エレクトロニクス㈱

ウェーハ検査

(3事業所)

- ・ラピスセミコンダクタ(株)
- ・旭化成エレクトロニクス㈱
- ・㈱吉川工業アールエフセミコン

前工程材料

(6事業所)

- ・SUMCO TECHXIV(株)
- ・(株)SHIN-SEI
- 千住技研(株)
- ・富士フイルム ワコーケミカル(株)
- ·日之出酸素㈱
- ・富士チタン工業㈱

【半導体製造装置分野】

半導体前工程設備・治具

(1事業所)

・㈱システム技研

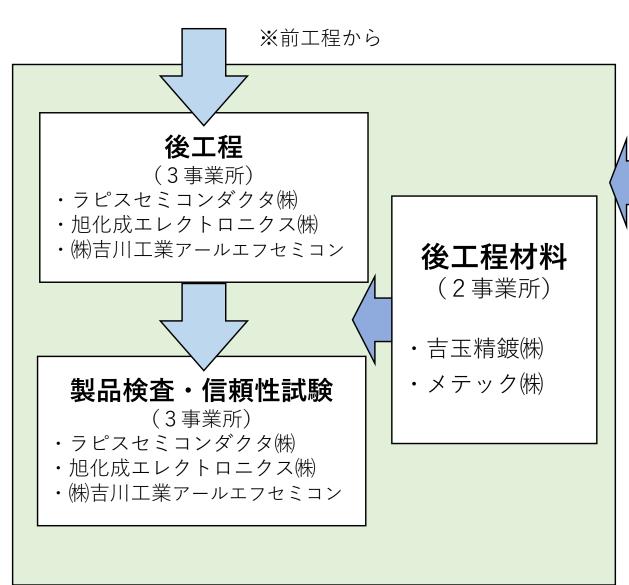
設備サービス・メンテナンス、 クリーンルーム、人材支援

(2事業所)

- ・(株)エフオーテクニカ
- ・㈱マイクロ電子サービス

「九州半導体関連企業サプライチェーンマップ(2022.3)」より

【半導体分野(後工程)】



【半導体製造装置分野】

半導体後工程設備・治具

(1事業所)

・㈱システム技研

設備サービス・メンテナンス、 クリーンルーム、人材支援

(2事業所)

- ・(株)エフオーテクニカ
- ・㈱マイクロ電子サービス

「九州半導体関連企業サプライチェーンマップ(2022.3)」より

【半導体利用産業分野】

回路設計・形成・制御ユニット設計

(1事業所)

・新生電子㈱

基板実装(6事業所)

- ・双信デバイス(株)・(株)マイクロ電子サービス
- ・新生電子㈱・えびの電子工業㈱
- ・ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)
- ・㈱吉川工業アールエフセミコン

制御ユニット (2事業所)

・双信パワーテック㈱・アルバック機工㈱

評価・解析(5事業所)

- ・ラピスセミコンダクタ(株)
- ・双信デバイス(株)・新生電子(株)
- ・ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱
- ・㈱吉川工業アールエフセミコン

組み込み系ソフトウェア (1事業所)

·新生電子(株)

【生産設備分野】

設計(3事業所)

・双信デバイス(株) ・(株)システム技研 ・(株)キョモトテックイチ

機械加工(6事業所)

- ・三倉物産㈱・ミクロエース㈱・㈱システム技研
- ・(有)桐木工作所・(株)昭和・日南テック(株)

板金・溶接・鋳物・エッチング等 (2事業所)

・(株)SHIN-SEI ・(株)昭和

熱処理・表面処理(3事業所)

・ミクロエース(株)・吉玉精鍍(株)・メテック(株)

樹脂成形・加工 (2事業所)

・旭有機材㈱・㈱ミヤザキ

機械要素・工具(1事業所)

· ㈱中園工業所

金型(4事業所)

- ・(株)巧研 ・ヒラサワプレシジョン(株)
- ・㈱システム技研 ・㈱キヨモトテックイチ

機械組立(2事業所)

・㈱システム技研 ・㈱中園工業所

1 その他報告事項(宮崎県内の半導体企業及び半導体関連企業の状況について)

3 みやざき半導体関連産業人材育成等コンソーシアムについて

「みやざき半導体関連産業人材育成等コンソーシアム」は、「半導体人材の育成・確保」や「会員企業の取引拡大等」に向けて取り組んでおり、「九州半導体人材育成等コンソーシアム」とも連携を図りながら取組を推進している。

みやざき半導体関連産業人材育成等コンソーシアム

<主な構成機関>

◆産・デバイス・装置・部素材製造販売、

メンテナンス、物流、 人材関係 企業・団体 等

◆学:宮崎大学、都城高専、

宮崎県高等学校教育研究会工業部会

◆**官:**県、市町村など

(オブザーバー:九州経済産業局)

<参加機関数>

65機関(産業界39、教育3、行政23)

※令和6年9月末現在

<目的>

- ・半導体人材の育成・確保
- ・会員企業の取引拡大等

九州半導体人材育成等コンソーシアム

<主な構成機関>

◆産:デバイス、装置、部素材、

人材関係 企業・団体 等

◆学:九大、熊大、高専機構等

◆**官:**経産省、文科省、各県・政令市、

産総研 等

(金) <参加機関数>

134機関(産業界62、教育30、

行政15、金融11、 協力機関16)

※令和6年9月末現在

<目的>

- ・半導体人材の育成と確保
- ・半導体大手企業と地場企業、ユーザー 企業との取引強化
- ・海外との産業交流の促進

連携